

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 孙悦文 陈宁玉 广发基金 马英皓 彤源资本 麦世学 长城基金 彭宇晖 天演论资本 常娜 沣谊投资 窦金虎 混沌投资 胡博清 兴合基金 陈诚 趣时资产 苗耀辉 徐远航 紫阁投资 段雨箫 新华基金 刘海彬 李浪 中颖投资 戴晶晶 中安汇富 罗鹏 博普资产 雍国铁 中银基金 杨国栋 山西证券 张天 淳厚基金 朱颜小悦 中庚基金 熊正寰 银叶投资 崔健 绯鹤基金 程文 恒泽投资 张嘉俊 兴业基金 刘体劲
时间	2026年1月8日 15:00-16:00
地点	公司A栋一楼培训室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士

投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司近期概况</p> <p>董事会秘书李良玉女士向各位参会方就公司基本情况、硅光子、光伏业务板块的行业发展状况及业务展望等方面进行了总体介绍。</p> <p>二、问题交流</p> <p>1、请问公司如何看待 CPO 技术未来的市场规模和下游需求增长预期？</p> <p>答复：从技术迭代与产业落地的底层逻辑看，CPO 作为适配高速率、高算力场景的关键技术，其市场规模的扩张是技术成熟度与下游场景需求共振的结果。ficonTEC 与国际顶尖科研机构、高校长期的前瞻性研发合作，包括德国弗劳恩霍夫研究所协会、爱尔兰廷德尔国家研究院、卡尔斯鲁厄理工学院、米兰理工学院、哥伦比亚大学、中佛罗里达大学、罗切斯特理工学院等，能够持续感知技术演进节奏，未来 CPO 市场或将呈现“多场景渗透+技术迭代驱动”的结构性增长态势，长期拓展空间将更为广阔。</p> <p>ficonTEC 在“原型机制作-小批量试产-大批量生产”全流程中积累的工艺经验，已融合至核心控制算法软件（PCM）中形成核心技术沉淀，同时借助机器学习对 PCM 的持续优化，能够快速响应客户的定制化需求，ficonTEC 作为全球光电子自动化设备领域的参与者，已依托上述核心竞争力深度嵌入 CPO 产业生态，后续将持续跟进产业节奏，相关业务进展若达到信息披露标准，将严格按规则履行披露义务，敬请投资者关注公司官方公告。</p> <p>2、请问公司 CPO 出货预期如何？ficonTEC 作为设备端供应商，如何配合客户推动在硅光及 CPO 领域量产化节奏？</p> <p>答复：公司 CPO 业务的出货节奏和预期主要根据下游客</p>
-------------------	--

户扩产节奏与差异化需求灵活适配。ficonTEC 作为全球光电子与半导体自动化封装测试领域的先进设备制造商，与全球顶尖客户保持长期战略合作。依托“From Lab to Fab”的业务模式，可为客户提供从研发验证、新产品导入（NPI）直至大规模量产的全生命周期支持，并已深度融入硅光、CPO、OCS 及 OIO 的产业生态链。

在光模块应用领域，伴随市场需求持续扩大，客户正积极推进建产能扩张，产品亦向更高速率方向迭代升级。单件产品价值提升、良率要求日趋严格，组装与测试流程复杂性显著增加。相较于传统依赖人力的制造方式，全自动化制造模式正日益凸显其在价值创造方面的显著优势。同时，结合罗博特科在智能工厂解决方案方面的技术积淀，以及 ficonTEC 在光电子端到端自动化设备领域的核心能力，我们正致力于为光电子行业构建完整的智能工厂解决方案。随着 CPO 技术持续演进，其工艺与半导体制造深度融合，在英伟达、博通等产业领袖的推动下，CPO 量产进程正不断加速。此外，光互连技术在芯片级互联（chip-to-chip）层面也取得重要进展，相关信息可进一步关注各领先科技企业的官方发布。

3、请问公司 OCS 订单预期大致呈现怎样的态势？

答复：公司在 OCS 技术路线上已与产业链核心参与者建立了深度协同关系，ficonTEC 近期与某瑞士客户签订了用于生产 OCS 核心模块的两条完整自动化产线设备订单。

该客户未来还有新的产线规划需求，公司将积极匹配其需求。鉴于下游客户的保密要求，具体细节暂不便进一步展开，后续若相关业务进展达到信息披露标准，公司将严格按照法律法规及信息披露制度的要求及时履行披露义务，敬请投资者关注公司官方公告。

4、请问公司当前产能布局是否匹配 CPO、OCS 等核心业务的增长需求？后续产能扩产的整体规划及关键支撑条件有哪些？

答复：根据未来市场的高速增长态势及核心客户提供的需求预测，公司亟需加速构建与之匹配的产能规模。得益于该业务板块的轻资产属性与公司模块化、集成化的运营模式，现有产能体系具备良好的弹性基础。目前，公司已从以下维度系统推进产能提升工作：

其一，依托重组后上市公司对 ficonTEC 的持续战略赋能，着力提升团队专业效能，重点加强设计、组装、调试等关键环节的人才梯队建设，并依据客户动态更新的需求预测，柔性配置生产与服务资源；

其二，拟通过港股市场融资重点投向产能扩充与全球服务网络建设，以全面响应全球客户需求。现阶段，ficonTEC 全球服务团队已实现规模性拓展，台湾及东南亚地区已完成服务团队的人员扩张和组建；

其三，在供应链层面，通过生态合作共建、供应商体系拓展及关键环节战略性备货等多措并举，持续优化供应链韧性。

随着 CPO、OCS 产业化进程加速，市场对 ficonTEC 设备的需求将显著攀升。目前公司设备已交付至亚太、北美、欧洲等全球主要市场，未来将基于客户需求在境内外同步布局产能提升，确保满足全球客户在交付周期与服务品质方面的要求，从而把握行业发展的战略窗口期。

5、请问公司在硅光领域的核心技术优势具体体现在哪些方面？相比行业同行，公司的技术壁垒主要依托什么建立？

答复：首先，ficonTEC 自身已有二十多年的发展和经验积累，在此基础上，其与国际顶尖研究机构的前瞻性研发协作，构成了其技术领先性的基石。自成立以来，ficonTEC 始终致

	<p>力于推动光子学领域基础技术的演进与革新，与全球一流科研院所及高等学府建立了长期稳定且深入的战略合作关系。多年来，这些前瞻合作持续为 ficonTEC 在光电子与量子技术领域的前沿工艺与技术优势提供了坚实支撑。</p> <p>其次，依托运动控制、视觉系统及 PCM 核心控制算法软件三大关键技术支撑，形成了覆盖硅光器件从晶圆测试到封装耦合、模块测试的全流程端到端解决方案，能够适配不同技术路线的自动化量产需求。</p> <p>最后， ficonTEC 贯彻 “从原型开发至小批量试产，再扩展至大规模量产”的业务模式。在此过程中，公司紧密协同下游客户需求，持续优化设备的功能、精度与效率，积淀了深厚的工艺经验。这些经验与设计知识已系统融入其核心控制算法软件（PCM）中，并通过软件迭代逐步形成了涵盖主动校准、全面光学组装与测试等在内的多项核心专有技术，构成公司核心竞争优势。这种基于长期实践所形成的知识体系，已转化为以算法软件为载体、嵌入产品设计的核心技术。任何团队或组织，若想复制或超越此类技术，均须经历漫长的实践积累与初始学习过程。此外，公司已将机器学习技术集成于 PCM 软件中，显著加速了算法优化与迭代进程，进一步巩固了技术壁垒的可持续性。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 8 日